

2023-2029年中国半导体封装用键合铜丝行业分析与市场年度调研报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2023-2029年中国半导体封装用键合铜丝行业分析与市场年度调研报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202304/350286.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2023-2029年中国半导体封装用键合铜丝行业分析与市场年度调研报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：

第一章 概述

第一节 键合内引线材料

一、半导体的引线键合技术发展

二、引线键合技术（WB）

三、载带自动键合技术（TAB）

四、倒装焊技术（FC）

第二节 键合丝及作用

一、键合丝定义及作用

二、键合丝在IC封装中的作用

第三节 键合丝的主要品种

第四节 键合金丝的主要品种分类

一、按用途及性能划分

二、按照键合要求的弧度高低划分

三、按照键合不同封装形式划分

四、按照键合丝应用的不同弧长度划分

第二章 键合铜丝行业、市场的情况

第一节 国际半导体封装用键合丝行业发展概述

第二节 封装用键合丝行业的发展特点

第三节 国际键合丝的市场情况

一、键合铜丝市场发展历程

二、企业制造技术的发展推动了键合铜丝市场扩大及格局的改变

三、当前国际及我国键合丝行业面临的问题

四、国际键合铜丝的市场规模

五、国际键合铜丝的市场格局

第四节 我国键合铜丝的市场情况

一、我国整体键合丝市场需求量情况

二、我国键合铜丝市场需求量情况

第三章 键合铜丝的性能与国外技术发展

第一节 半导体封装工程对引线键合材料——键合丝的性能要求

一、引线键合在半导体封装制造中的应用

二、对半导体封装工程对引线键合材料——键合丝的性能要求

三、对键合铜丝的主要特性要求

（一）对键合铜丝的物性要求

（二）对键合铜丝的表面性能要求

（三）对键合铜丝的线径要求

第二节 键合丝的主要采用的标准情况

一、国内外半导体键合用键合丝的主要标准

二、我国半导体键合用铜丝标准的编制情况

第三节 键合铜丝的特性

一、键合铜丝与其它键合丝主要性能对比

二、键合铜丝的成本优势

三、键合铜丝的性能优势

第四节 国外主要企业的键合铜丝产品品种及性能

一、国外键合铜丝产品发展概述

二、田中贵金属公司的四种产品

三、新日铁公司的覆PD键合铜丝

四、贺利氏公司的三种键合铜丝产品

五、MEK电子公司的三种键合铜丝产品

第四章 键合铜丝的制造工艺过程及产品知识产权情况

第一节 键合铜丝的制造工艺技术

一、键合铜丝的制造工艺流程简述

二、具体工艺的环节

(一) 坯料铸造

(二) 成丝加工

(三) 热处理

(四) 复绕(卷线)

第二节 键合铜丝制备过程及影响因素

第三节 键合铜丝的组织与微结构

第四节 键合铜丝知识产权情况

一、国际及我国键合铜丝专利情况

二、新日铁公司实施专利战略的情况

第五章 国际键合铜丝的主要生产企业现况

第一节 国际键合金丝的主要生产厂家概述

第二节 国际键合铜丝的主要生产厂家及其产品情况

一、田中贵金属株式会社

二、贺利氏集团

⋯⋯

第六章 我国国内键合铜丝的主要生产企业及其产品情况

第一节 概述

一、中国键合丝行业总况

二、中国键合丝生产及其企业分布情况

三、中国键合铜丝行业的生产情况

第二节 中国键合铜丝的主要生产厂家及其产品情况

一、贺利氏招远(常熟)电子材料有限公司

二、烟台招金励福贵金属股份有限公司

三、河南优克电子材料有限公司

⋯⋯

第三节 中国其它新建、在建的键合铜丝生产厂家情况

一、广州佳博金丝科技有限公司

⋯⋯

第七章 键合铜丝应用市场的现状与发展

第一节 国际半导体封测产业概况及市场

第二节 我国半导体封测产业发展及现况

一、中国IC封装测试业生产现况

二、我国国内分立器件生产企业情况

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202304/350286.html>